# 中信建投证券股份有限公司

# 关于

# 珠海市杰理科技股份有限公司
# 首次公开发行股票并在创业板上市
# 之

# 上市保荐书

**保荐机构**

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二一年九月

# 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人谭永丰、陈涛已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

# 目　录

释　义.....3
一、发行人基本情况.....5
二、发行人本次发行情况.....19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....20
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....21
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见.....22
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项.....23
七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明.....24
八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《上市规则》上市条件的说明.....24
九、持续督导期间的工作安排.....25
十、保荐机构关于本项目的推荐结论.....26

# 释　义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

| | | |
|---|---|---|
| 中信建投证券、保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 本上市保荐书、上市保荐书 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》 |
| 发行人、杰理科技、公司 | 指 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
| 华虹集团 | 指 | 上海华虹（集团）有限公司及其下属子公司，包括下属上海华力集成电路制造有限公司、上海华力微电子有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司等，系晶圆代工厂商 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司及其下属子公司，上海证券交易所及香港联合证券交易所上市公司，证券代码分别为688981.SH和0981.HK，系晶圆代工厂商 |
| 华润上华 | 指 | 无锡华润上华科技有限公司，系晶圆代工厂商 |
| 华天科技 | 指 | 天水华天科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，证券代码 002185.SZ，系芯片封装测试厂商 |
| 通富微电 | 指 | 通富微电子股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，证券代码 002156.SZ，系芯片封装测试厂商 |
| 米飞泰克 | 指 | 深圳米飞泰克科技有限公司，系晶圆测试及芯片封装测试厂商 |
| 珠海建荣 | 指 | 建荣集成电路科技（珠海）有限公司 |
| 香港卓荣 | 指 | 卓荣集成电路科技有限公司 |
| 集成电路、IC、芯片 | 指 | Integrated Circuit 的简称，是指经过特种电路设计，采用一定的半导体加工工艺，把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块硅、锗等半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的一种微型电子电路 |
| SoC、SoC 芯片 | 指 | System on Chip，即系统级芯片、片上系统，将系统关键部件集成在一块芯片上，可实现完整系统功能的芯片电路 |
| 智能终端 | 指 | 带有微型计算机的终端，具有信息交互、数据存储与信息处理等功能，如射频智能终端、多媒体智能终端等 |
| 蓝牙、BT | 指 | Bluetooth，一种支持设备短距离通信的无线电技术及其相关通信标准，通过它能在移动设备终端之间进行无线信息交换 |
| WiFi | 指 | WiFi 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术，通常使用 2.4G UHF 或 5G SHF ISM 射频频段 |
| IP、IP 核 | 指 | Intellectual Property core 的简称，IP 核指知识产权核或知识产权模块。IP 核是将一些在数字电路中常用，但比较复杂的功能块，如 FIR 滤波器、SDRAM 控制器等设计成可修改参数的模块，具有可重用性、通用性、可移植性等特点 |
| 主动降噪、ANC | 指 | Active Noise Cancellation 的简称，一种用于耳机降噪的方法。通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音抵消，从而实现降噪的效果 |

| | | |
|---|---|---|
| EDA | 指 | Electronics Design Automation 的简称，指电子设计自动化，以计算机为工作平台，是 IC 电子行业必备的设计工具软件。以计算机为工具，设计者在 EDA 软件平台上，将芯片从电路设计、性能分析到设计出 IC 版图的整个过程都交由计算机自动处理完成 |
| SIG | 指 | Bluetooth Special Interest Group 的简称，指蓝牙技术联盟，由电信、计算机、汽车制造、工业自动化和网络行业的领先厂商组成，致力于推动蓝牙无线技术的发展，为短距离连接移动设备制定低成本的无线规范，并将其推向市场 |
| Fabless | 指 | Fabrication 和 less 的组合，即垂直分工制造模式，是指企业只从事集成电路的设计，集成电路产品生产所经历的晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等环节分别委托给专业的晶圆代工企业、芯片封装测试企业代工完成。目前，全球绝大部分集成电路设计企业均采用 Fabless 模式，主要代表有高通、联发科、海思半导体、紫光展锐等企业 |
| 联发科 | 指 | 联发科技股份有限公司，全球知名 IC 设计企业之一，中国台湾地区上市公司，证券代码 2454.TW |
| QCY | 指 | 东莞市和乐电子有限公司，旗下拥有 QCY 品牌 |
| nm | 指 | 纳米，长度单位，1 纳米相当于 1 米的十亿分之一 |
| 本次发行 | 指 | 公司拟首次公开发行不低于 4,257.50 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《珠海市杰理科技股份有限公司章程》，公司现行公司章程 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月 |
| 最近三年 | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本上市保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

# 一、发行人基本情况

## （一）发行人概况

1、中文名称：珠海市杰理科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Jieli Technology Co., Ltd.

2、注册资本：38,317.50万元

3、法定代表人：王艺辉

4、有限公司设立日期：2010年8月30日

5、整体变更为股份公司日期：2016年10月21日

6、公司住所：珠海市香洲区科兴路333号

邮政编码：519060

7、电话号码：0756-6313575

传真号码：0756-6313575

8、互联网网址：http://www.zh-jieli.com

9、电子信箱：security@zh-jieli.com

10、信息披露和投资者关系部门：证券事务部

11、信息披露和投资者关系部门负责人：李翰韬

12、信息披露和投资者关系部门联系电话：0756-6313575

## （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

### 1、主营业务

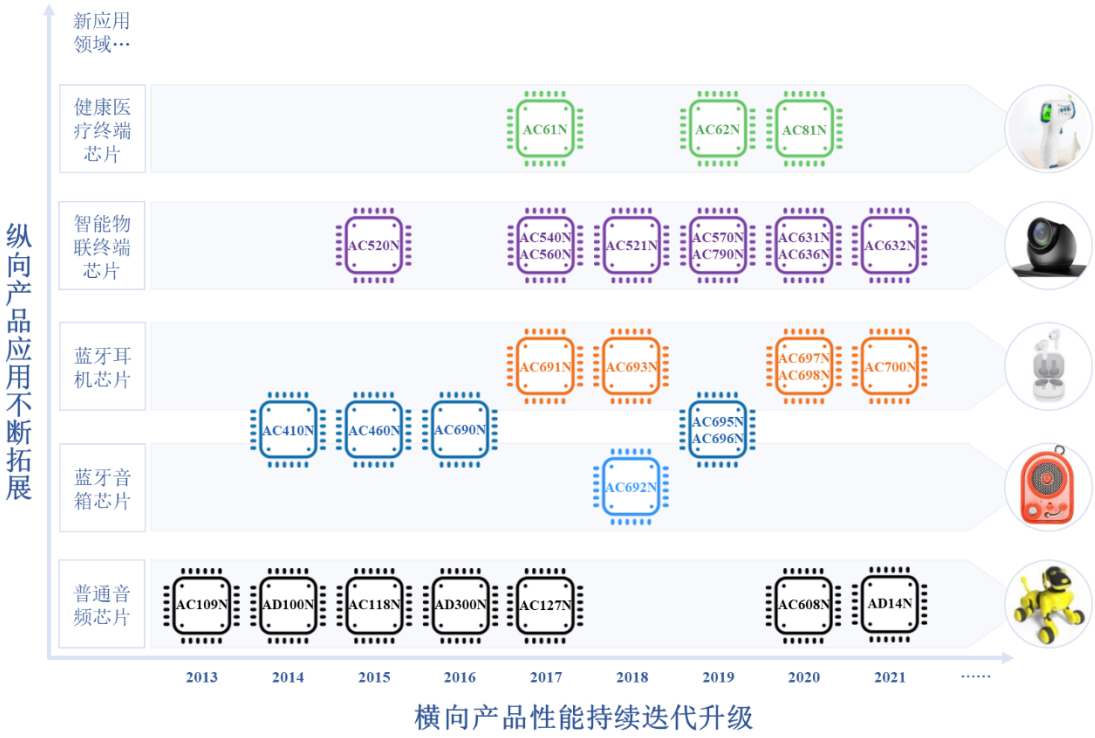
公司专业从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片（SoC）的研究、开发和销售，致力于为客户提供高规格、高灵活性与高性价比平衡的主控平台芯片和“SoC 解决方案”一站式服务。

依托射频及多媒体技术创新平台，公司不断拓展产品系列及应用领域。目前，公司已形成以蓝牙耳机芯片和蓝牙音箱芯片为主，同时涵盖智能物联终端芯片、健康医疗终端芯片、普通音频芯片等智能终端芯片的平台化发展格局。

公司产品具有高规格、高灵活性与高性价比平衡的显著特点，以及“SoC 解决方案”一站式服务优势。高规格方面，公司芯片产品集成度高，整体性能达到行业主流水平，部分指标位居行业前列；高灵活性方面，公司芯片设计针对性强，可根据不同应用场景及各类型消费需求准确匹配相应产品，且具备较高可扩展性，能够适时跨产品线快速开发；高性价比方面，公司产品在满足性能和功能需求的同时尽可能减少冗余资源，有效降低产品成本。与此同时，公司凭借丰富的产品应用经验，参考联发科“Turnkey Solution”（交钥匙完整解决方案）模式，为客户提供便捷的标准软件包及辅助开发工具，客户通过“点菜式”二次开发即可获得新产品方案，有效缩短下游开发周期、降低批量生产难度和成本，实现“SoC 解决方案”一站式服务。

公司自成立以来坚持自主研发，已形成对核心架构、音视频算法以及自有 IP 等核心技术的高度自主可控。截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有授权发明专利 122 项、集成电路布图设计 56 项以及全面的自主 IP 体系，研发人员占比达到 75.31%。公司多款系列产品荣获“中国芯”称号，并多次获得“中国半导体创新产品和技术”等奖项，产品性能和市场表现得到行业权威认可。通过紧贴市场需求进行自主、快速研发，公司不断进行迭代升级提升产品性能，并持续推进新应用领域的拓展，以每年研发量产 2-4 个系列的速度推出市场热销产品，升级用户体验。

**公司主要产品迭代及应用拓展示意图**




依托显著的产品优势，公司已成为蓝牙音频芯片（包括蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片）的主要提供商，亦成为蓝牙音频产品的推广者和普及者。根据 SIG 发布的数据，2018-2020 年全球蓝牙音频传输设备出货量共 32 亿台，而同期公司蓝牙音频芯片销量累计超过 27 亿颗（大部分蓝牙耳机配备 2 颗主控芯片），市场地位显著，公司产品的大规模应用引领着全球蓝牙音频产品的普及化风潮。与此同时，依托平台化研发优势，公司实现产品线快速拓展及新应用领域快速切入，近年来已成为智能物联终端芯片、健康医疗终端芯片领域的主要市场参与者和竞争者。目前，公司产品已进入包括小米、传音、QCY、奋达科技、山水音响、猫王、凌度、任我游、惠普、飞利浦、夏新、联想、摩托罗拉、先科等在内的众多知名终端品牌厂商，产品受到市场广泛欢迎。

面对日新月异的科技发展，公司致力于让更多人享受到科技带来的乐趣，实现“用‘芯’美好世界”的企业愿景。未来，公司将持续为全球用户提供兼具高规格、高灵活性与高性价比的芯片产品，专注于智能终端芯片平台化研发和拓展，将公司的主控平台芯片广泛推向智慧家庭、智能穿戴、物联网、智慧医疗等智能终端应用场景，实现公司经营业绩持续快速增长。

**2、核心技术**

公司形成了以专有技术为主的核心技术体系和技术创新体系。凭借深厚的技术底蕴和丰富的技术经验，公司掌握了系统架构和处理器设计技术、超低功耗技术、蓝牙BLE技术、蓝牙TWS技术、WiFi技术、高性能音频ADC/DAC技术、高性能主动降噪（ANC）技术、双麦克风ENC技术、图像处理技术、视频编解码技术、语音识别及视觉处理技术等多项核心技术。公司已实现芯片设计相关的核心架构、音视频算法以及自有IP等核心技术的高度自主可控。通过持续技术创新，公司芯片设计实现了集成度高、针对性强、开发灵活，芯片性能不断提升的同时所需资源持续优化，产品成本持续降低。

**3、研发水平**

（1）取得的发明专利等知识产权情况

公司坚持自主研发，已形成对核心架构、音视频算法以及自有IP等核心技术的高度自主可控，并获得了一系列专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权的授权。截至2021年3月31日，公司拥有授权发明专利122项（含2项境外发明专利）、集成电路布图设计56项、软件著作权100项以及全面的自主IP体系。

（2）核心技术的科研实力和成果情况

截至本上市保荐书出具之日，公司获得的主要荣誉如下：

| 序号 | 企业荣誉 | 获奖年份 | 授予/批准单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年度珠海市最具成长性集成电路企业 | 2021 | 珠海市半导体行业协会 |
| 2 | 2020年度珠海市最佳集成电路技术创新产品 | 2021 | 珠海市半导体行业协会 |
| 3 | 第七届广东专利优秀奖（蓝牙音频播放同步的方法、装置及蓝牙音频播放装置） | 2020 | 广东省人民政府 |
| 4 | 2020年第十五届“中国芯”优秀市场表现产品 AC693N | 2020 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 5 | 2020年第十五届“中国芯”优秀支援抗疫产品-AC61N | 2020 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 6 | 第十三届中国半导体创新产品和技术-BR20 | 2019 | 中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社 |
| 7 | 2018年珠海市高新技术企业成长百强企业 | 2018 | 珠海市科技和工业信息化局 |

| 序号 | 企业荣誉 | 获奖年份 | 授予/批准单位 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2018年珠海市高新技术企业综合实力百强企业 | 2018 | 珠海市科技和工业信息化局 |
| 9 | 2018年珠海市高新技术企业税收百强企业 | 2018 | 珠海市科技和工业信息化局 |
| 10 | 第十二届中国半导体创新产品和技术-BR17 | 2018 | 中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社 |
| 11 | 第十三届“中国芯”优秀技术创新产品-AC691X | 2018 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |
| 12 | 第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术（BT15） | 2017 | 中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社 |
| 13 | 珠海市知识产权优势企业 | 2016 | 珠海市知识产权局 |
| 14 | 第十一届“中国芯”最具投资价值企业 | 2016 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |
| 15 | 第十一届“中国芯”最佳市场表现产品-BT15 | 2016 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |
| 16 | “通用高集成双解码控制芯片-HB002”科学技术进步奖三等奖 | 2015 | 珠海市人民政府 |
| 17 | 第十届“中国芯”最具创新应用产品奖-AC4100 | 2015 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |

（3）研发投入情况

报告期内，公司持续保持较高的研发投入水平，研发投入累计达到 36,113.76 万元，占同期累计营业收入的比例为 6.37%，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 3,956.08 | 13,266.16 | 11,095.69 | 7,795.82 |
| 营业收入 | 52,964.07 | 214,116.04 | 165,736.95 | 133,689.12 |
| 占营业收入比例 | 7.47% | 6.20% | 6.69% | 5.83% |

**（三）发行人主要经营和财务数据及指标**

**1、合并资产负债表主要数据**

单位：万元

| 项目 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 212,392.73 | 175,315.51 | 127,638.19 | 78,554.39 |
| 负债总额 | 48,136.03 | 49,720.98 | 31,759.88 | 18,052.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,256.70 | 125,594.53 | 95,878.31 | 60,501.50 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 164,256.70 | 125,594.53 | 95,878.31 | 60,501.50 |

## 2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 52,964.07 | 214,116.04 | 165,736.95 | 133,689.12 |
| 营业利润 | 11,541.69 | 50,183.15 | 42,919.76 | 30,303.55 |
| 利润总额 | 11,496.63 | 50,112.20 | 42,904.42 | 30,303.41 |
| 净利润 | 10,661.95 | 46,180.70 | 39,339.12 | 26,568.94 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,661.95 | 46,180.70 | 39,339.12 | 26,568.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 10,150.32 | 45,346.59 | 38,471.69 | 25,972.16 |

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,072.95 | 47,231.12 | 50,521.20 | 18,543.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,526.17 | -6,606.75 | -9,469.03 | -1,477.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,995.13 | -16,460.00 | -3,960.00 | -3,029.01 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -4.48 | -2.32 | 5.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,396.23 | 24,159.90 | 37,089.85 | 14,042.11 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 107,883.98 | 102,487.74 | 78,327.85 | 41,237.99 |

## 4、主要财务指标

| 财务指标 | 2021-3-31/ 2021 年 1-3 月 | 2020-12-31/ 2020 年度 | 2019-12-31/ 2019 年度 | 2018-12-31/ 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 4.00 | 3.16 | 3.53 | 4.10 |
| 速动比率（倍） | 2.51 | 2.24 | 2.64 | 2.54 |
| 资产负债率（母公司） | 22.86% | 28.49% | 25.04% | 23.20% |
| 资产负债率（合并） | 22.66% | 28.36% | 24.88% | 22.98% |
| 应收账款周转率（次/年） | - | - | - | - |
| 存货周转率（次/年） | 0.64 | 4.17 | 4.06 | 4.46 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 11,872.59 | 50,782.28 | 43,465.43 | 30,727.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 10,661.95 | 46,180.70 | 39,339.12 | 26,568.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 10,150.32 | 45,346.59 | 38,471.69 | 25,972.16 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 7.47% | 6.20% | 6.69% | 5.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.50 | 1.27 | 1.40 | 0.52 |
| 每股净现金流量（元） | 0.14 | 0.65 | 1.03 | 0.39 |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 4.29 | 3.39 | 2.66 | 1.68 |

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率＝负债总额/资产总额；
4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率＝营业成本/存货平均净额；
6、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息费用+折旧+摊销；
7、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入；
8、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；
10、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末总股本。

**（四）发行人存在的主要风险**

**1、创新风险**

公司采用 Fabless 模式经营，专业从事集成电路的研究开发，持续开展研发创新是推动公司发展的核心动力。近年来，随着半导体、物联网、人工智能等技术的不断进步，SoC 芯片行业发展日新月异，市场需求快速演变。自成立以来，公司始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路，不断进行技术创新和产业转化，不断推动产品技术升级。如果公司未来研发创新机制发生变化、对行业发展趋势的判断发生偏差，公司将面临科技创新失败、产品和技术无法获得市场认可，进而无法保持市场领先地位及竞争优势的风险。

**2、技术风险**

（1）技术升级导致产品迭代风险

集成电路设计行业具有技术升级迭代及产品更新换代速度快的特点，持续研发新技术、推出新产品是集成电路设计公司在市场竞争中保持优势的重要手段。目前，行业内企业主要根据市场需求和工艺水平对现有技术进行升级迭代，以持续保持产品竞争力。报告期内，公司以每年迭代升级 2-4 个系列芯片产品的速度持续推出市场热销产品，保持了较强市场竞争力。如未来公司不能紧跟行业技术发展趋势对产品进行持续的迭代和升级，将导致公司产品失去市场竞争力，进而对公司业务发展和盈利能力造成不利影响。

（2）研发失败风险

报告期内，公司持续投入大量资源进行技术和产品研发，研发费用分别为 7,795.82 万元、11,095.69 万元、13,266.16 万元以及 3,956.08 万元。公司当前仍有大量在研项目，预计未来仍将保持较高的研发投入力度。由于新技术应用和新

产品的市场化存在一定不确定性，未来如果公司不能正确把握研发方向，或者在研发过程中无法突破关键技术、产品性能指标未达预期，或者推出的新产品不能及时契合市场需求，或者产品不具备成本优势等，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，并对公司业务发展和市场竞争力造成不利影响。

（3）知识产权风险

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，公司拥有的自主知识产权体系是公司核心竞争力的重要组成部分。长期以来，公司高度重视知识产权保护，通过申请专利、商标、软件著作权、集成电路布图设计专有权等途径确保拥有的知识产权合法、有效。但由于市场竞争日趋激烈，侵犯公司知识产权的行为可能无法得到及时防范和制止。如果公司的知识产权不能得到充分保护，相关核心技术被泄密，被竞争对手获知和模仿，则公司的竞争优势可能会受到损害；或行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权，知识产权纠纷将耗费公司大量人力物力，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

（4）专利可能被提起无效宣告的风险

公司曾存在部分专利被珠海建荣及其相关方以相关专利不具有新颖性、创造性等理由提起无效宣告的情形。专利权无效宣告程序是对专利权有效性进行再确认的程序，若专利最终被宣告无效，原专利申请人将丧失对技术的垄断权，即不能依据《专利法》排除他人使用该技术，但原专利申请人仍可以基于该技术为公知技术而继续使用，原专利申请人与宣告无效请求人之间也并不因此产生专利侵权纠纷。

公司自成立以来，通过自主研发和持续技术创新，形成了以专有技术为主的核心技术体系。报告期内，公司被提起无效宣告的专利所对应技术均不涉及公司的核心技术，对公司生产经营和业绩没有实质性影响，且被宣告无效后的专利技术公司仍能基于公知技术而继续使用，也未产生专利侵权纠纷。

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人共拥有 165 项授权专利，其中发明专利 122 项（含 2 项境外发明专利），实用新型专利 43 项；公司现有专利不存在正被提起无效宣告的情形，但公司不排除部分专利未来可能被提起无效宣告、经复审后可能被宣告无效的风险。

（5）EDA设计工具技术授权风险

公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专业从事集成电路研发设计。在研发过程中，公司需要获取 EDA 工具提供商的技术授权。报告期内，公司已取得 Cadence（楷登电子）、Synopsy（新思科技）、Mentor Graphics（西门子 EDA）等 EDA 工具提供商的技术授权。公司 EDA 设计工具供应商集中度较高，主要系受集成电路行业中 EDA 市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与上述供应商保持了长期持续的良好合作，但是如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，上述 EDA 供应商均不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生重大不利影响。

（6）核心技术泄密风险

通过自主研发和持续技术创新，公司已形成了以专有技术为主的核心技术体系。该等核心技术是公司持续创新、保持竞争优势的有力保障，核心技术保密对公司的发展极其重要，公司亦相应采取了严格的保密措施。若公司新产品、新技术研发过程中因核心技术保密不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力产生不利影响。

**3、经营风险**

（1）公司业绩波动风险

报告期内，公司坚持贴近市场、快速响应、自主研发，经营业绩保持较快增长。公司未来仍将以智能终端芯片产品为主，智能终端市场需求的波动将直接影响公司的经营业绩。智能终端产品细分市场规模的变化、产品更新换代、国内外经济贸易环境变化等因素均可能导致下游市场需求发生波动。如果公司主要产品应用的射频智能终端、多媒体智能终端等市场需求出现下滑，同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场，将导致公司主营业务收入和净利润面临波动、公司业绩不能持续保持快速增长的风险。

（2）市场竞争风险

智能终端产品及技术更新换代速度快、用户需求和市场竞争状况也在不断演变，市场竞争激烈。一方面，公司在资本实力、经营规模、技术储备等方面与国内外大型集成电路设计企业对比仍存在提升空间；另一方面，公司还面临行业新进入者可能采用的同质化、低价格竞争。

若未来公司新技术、新产品的研发及市场推广不能及时满足市场动态变化，公司可能无法在激烈的市场竞争中持续保持并增强自身竞争力，进而对公司业务发展和经营业绩造成不利影响。

（3）专业人才引进不足及流失风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，是否拥有与企业发展所匹配的一批研发、管理和销售人才是行业内企业竞争力的重要体现。一方面，公司已拥有一支高素质的人才团队，团队稳定且构成合理，但随着公司经营规模的快速发展，尤其是募投项目实施之后，公司对于高素质、专业化的优秀技术、管理、销售人才的需求将增加；另一方面，随着竞争加剧，同行业企业对人才的争夺也使得公司存在人才流失风险。若公司专业人才不能及时引进或既有人才团队出现大规模流失，公司业务经营可能会受到不利影响。

（4）产业链协作和产能供应不足风险

与国内外绝大多数 IC 设计企业相一致，公司采用 Fabless 经营模式，主要负责集成电路研发和设计环节，晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试均委托给上游专业晶圆代工厂商、晶圆测试厂商、芯片封装测试厂商完成。上游厂商的工艺技术水平、交货时间、生产能力等均对公司的产品生产有一定影响。如果上游厂商出现产能紧张、生产事故、意外停产、管理不善等情况，可能导致产业链协作不利和产能供应不足的风险，进而对公司的订单交付和收入实现带来不利影响。

（5）主要供应商集中风险

报告期内，公司前五大供应商采购金额分别为 99,217.31 万元、99,075.82 万元、142,109.05 万元和 54,937.09 万元，占当期采购总额的比例分别为 88.02%、76.89%、80.22%和 81.88%，采购集中度较高。公司主要供应商包括华虹集团、中芯国际、华润上华、华天科技、华润安盛、合肥恒烁、普冉股份等国内知名晶圆制造、芯片封装测试及配套封装芯片厂商。

公司与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，保持着良好的协同合作效应。若突发重大自然灾害等事件，或因市场需求量旺盛、偶发性供应不足或供应商自身原因等因素导致主要供应商无法满足公司采购需求，而公司未能及时拓展新的供应商进行有效替代，则会对公司经营产生不利影响。

（6）业务区域集中度高的风险

报告期内，公司在深圳地区的营业收入分别为 132,578.41 万元、163,618.65 万元、210,000.19 万元和 51,513.78 万元，占当期营业收入的比例超过 95%，公司业务区域集中度较高。该情况与部分同行业可比公司的客户区域分布情况基本一致，是我国集成电路下游应用产业生产、销售格局分布所致。

深圳地区电子行业发达，是国内 IC 设计产业规模最大的城市，2020 年 IC 设计产业规模占国内整体规模的比例超过 34%，智能终端产品研发、生产、销售发达，市场空间巨大。各 IC 设计企业都把深圳地区置于重要的战略位置，积极拓展深圳市场。但如果未来国内电子信息产业政策发生变化或其他因素导致我国集成电路产业区域格局发生重大变化，将可能对公司未来的业绩产生不利影响。

（7）主要客户集中度高的风险

报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 71.79%、65.10%、54.07%和 48.17%，集中度相对较高。公司与主要客户已建立长期稳定的合作关系，但如果主要客户因生产经营或资信状况发生重大不利变化等原因减少或终止从公司的采购，且公司在新产品开发、新客户和新市场开拓等方面未能及时取得成效，则公司经营业绩将面临下滑风险。

（8）国际贸易政策变化对公司经营产生影响的风险

报告期内公司产品主要销往境内市场，但采用公司芯片的智能终端产品部分销往境外市场。如果未来相关国家或地区出于贸易保护或其他原因，通过贸易政策、关税、进出口限制等方式构建贸易壁垒，限制公司客户及下游厂商在当地市场的业务开展，可能导致公司客户及下游厂商对公司芯片的需求降低，甚至不再采用公司芯片，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（9）新冠病毒疫情影响的风险

2020 年以来，新冠病毒疫情对国内外宏观经济及各行各业造成冲击，公司所处集成电路产业亦受到不利影响，具体表现为上下游复工延迟带来的供需紧张、物流受阻导致采购销售不畅、终端市场需求波动等方面。虽然目前国内新冠肺炎疫情形势好转，但海外疫情形势仍较为严峻，世界经济下行风险加剧。如果未来疫情出现反复或在海外其他国家或地区无法得到有效控制，将会对全球集成电路产业链持续造成不利影响，进而影响公司经营业绩。

**4、内控风险**

（1）实际控制人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人王艺辉、张启明、张锦华、胡向军直接和间接合计控制公司 84.07%股份；本次发行后，王艺辉、张启明、张锦华、胡向军仍为公司的实际控制人。

虽然公司已经建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度，包括制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司、侵犯中小股东利益现象的发生，但若实际控制人利用其持股比例优势行使表决权，对发行人的经营决策加以控制，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。

（2）内控体系建设及内控制度执行的风险

公司已经按照有关法律法规和制度的要求，建立健全了各项内部控制制度，形成了相对完善的内部控制体系。内控制度的有效运行，保证了公司的经营管理活动正常有序开展，并有效控制风险。但随着业务规模持续扩大，经营管理、财务监控、资金调配等工作日益复杂，将对公司的内部控制提出更高要求。如果公司内部控制体系不能随公司的发展不断完善并得到有效执行，则可能对经营产生不利影响。

（3）经营管理风险

随着业务和资产规模逐渐增长，公司经营活动更趋复杂，对公司业务布局、组织架构、内部控制、人员管理等方面都提出了更高的要求。如果公司经营管理水平和组织架构设置不能满足公司业务和资产规模的扩大，将对公司的技术创新、新产品研发、市场竞争、经营管理等方面带来不利影响。

**5、财务风险**

（1）毛利率下降的风险

报告期内，公司营业收入毛利率分别为 28.37%、31.49%、28.85%和 29.92%，波动较小。公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点，如果未来出现市场竞争者持续增加、原有竞争对手加大研发力度和市场开发力度、下游市场规模增速放缓、上游供应商材料价格上涨、国际贸易摩擦加剧等

情况，可能导致产品销售价格下降、成本上升，进而影响行业整体毛利率，导致公司毛利率存在下降的风险。

（2）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 27,834.26 万元、28,091.09 万元、45,022.82 万元以及 70,398.26 万元，占公司流动资产比重分别为 37.97%、25.28%、29.16%和 37.35%，占比相对较高。公司存货由委托加工物资、库存商品构成。随着销售规模的扩大和新产品的推出，公司存货余额也会随之上升，如果不能够加强对存货的管理、提高其周转效率，将面临流动性下降的风险。此外，市场竞争的加剧、销售价格下降、产品更新换代等因素，可能导致存货可变现净值低于成本，公司存在存货跌价的风险。

（3）净资产收益率下降的风险

最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 52.52%、49.62%、40.69%和 7.75%。若公司本次股票成功发行，公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，如果在此期间公司的盈利能力没有大幅提高，公司可能存在净资产收益率下降的风险。

（4）税收优惠政策的变动风险

报告期内，公司在企业所得税、增值税即征即退等方面享受了国家的税收优惠政策。2018 年，公司享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税率为 15%；2019 年、2020 年，公司享受软件和集成电路产业企业所得税优惠政策，企业所得税率为 10%；同时，报告期内公司享受软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠政策。如果公司自主创新能力下降，不能持续符合高新技术企业或软件和集成电路产业税收优惠政策，或国家调整上述税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，则公司企业所得税、增值税等税费将增加，税后经营业绩将受到一定的影响。

**6、法律风险**

（1）诉讼风险

截至本上市保荐书出具之日，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在作为一方当事人的重大未决诉讼或仲裁

事项。报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人曾被珠海建荣及其关联方香港卓荣提起诉讼，认为公司等主体侵害其商业秘密及集成电路布图设计专有权，该等诉讼均已由珠海建荣、香港卓荣主动撤回。

公司自设立以来一直坚持自主研发，不存在侵害珠海建荣及其关联方商业秘密及知识产权的情形；虽然香港卓荣、珠海建荣均已主动撤回相关诉讼，但随着市场竞争程度的加剧，公司不排除未来仍可能面临被竞争对手或其他方提起诉讼或仲裁的风险。

（2）租赁房产产权瑕疵风险

公司及子公司存在租赁临时建筑、未办理产权证房产的情形，该等租赁房产存在产权瑕疵。未来不排除出现该等租赁房产因产权瑕疵被责令拆除、相关租赁合同不能继续履行、到期无法续租等情形。

该等产权存在瑕疵的租赁房产主要用于子公司深圳杰理办公及研发、仓储、宿舍，不涉及生产。若因该等租赁房屋的产权瑕疵问题导致公司无法继续使用该等租赁房产，公司需寻找可替代场所，并可能产生与此相关的额外费用，从而短期内对公司造成一定不利影响。

**7、发行失败风险**

发行人本次拟公开发行不低于 4,257.50 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，发行方式采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。但若本次发行出现相关法律法规中规定的中止发行或终止发行的情形，可能导致本次发行失败的风险。

**8、募集资金投资项目风险**

（1）募集资金项目实施的风险

本次募集资金主要用于提升公司综合研发实力，增强公司在蓝牙音频、物联网、健康医疗等领域的既有产品升级及新产品开发能力。本次募集资金投资项目是在结合国家产业政策，深入分析行业现状和未来发展趋势的基础上制定的，但随着集成电路产业的快速发展，公司存在因产业政策调整、市场变化、技术革新等方面的因素或其他不可预见的因素导致项目延期或无法实施，或者可能导致投资项目不能产生预期经济效益。

此外，本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和完成质量。若公司组织实施不当，可能导致投资项目不能按期完成，进而对公司经营业绩带来不利影响。

（2）募集资金投资项目达产初期未能实现效益甚至亏损的风险

公司本次首次公开发行股票拟募集资金 25.00 亿元。募投项目逐步实施后，公司将新增大量的研发费用以及资产投入。受产品的研发试制、产品认证、市场推广等因素的影响，公司募投项目研发完成至实现效益需要一定的过程，在募投项目产生收益前，将存在因费用增加较大影响当期利润的风险。另外，如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

**9、股票价格波动风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平、发展前景的影响，而且受到投资者心理预期、股票供求关系以及政治、宏观经济、金融政策等因素的影响。公司股票的价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

## 二、发行人本次发行情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| **股票种类** | 人民币普通股（A 股） | | |
| **每股面值** | 人民币 1.00 元 | | |
| **发行股数** | 不低于 4,257.50 万股 | **占发行后总股本比例** | 不低于 10.00% |
| **其中：发行新股数量** | 不低于 4,257.50 万股 | **占发行后总股本比例** | 不低于 10.00% |
| **股东公开发售股份数量** | 不适用 | **占发行后总股本比例** | 不适用 |
| **发行后总股本** | 不低于 42,575.00 万股 | | |
| **发行方式** | 采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票） | | |
| **发行对象** | 符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外） | | |
| **承销方式** | 余额包销 | | |

## 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

### （一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定谭永丰、陈涛担任杰理科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

谭永丰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：五株科技、江波龙等 IPO 项目；中航光电、南京熊猫、炼石有色、苏交科、诺普信、凯中精密非公开发行，苏交科、博世科向特定对象发行，崇达技术可转债，香雪制药配股等再融资项目；中航电子、中航精机、南京熊猫等并购重组项目。目前无作为保荐代表人履行尽职推荐的在会项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈涛先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：文灿股份、紫晶存储等 IPO 项目；红相股份、佳都科技非公开，红相股份可转债，苏交科向特定对象发行等再融资项目；东方精工、红相股份、思维列控等并购重组项目。目前无作为保荐代表人履行尽职推荐的在会项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### （二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为黄勇，其保荐业务执行情况如下：

黄勇先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：南方测绘等 IPO 项目，红相股份发行股份购买资产项目。

### （三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括杨恩亮、李奕辰、王秋韵、刘建亮、刘实。

杨恩亮先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：威尔药业、东岳硅材、派能科技等 IPO 项目；澳柯玛、光莆股份、锦泓集团非公开发行等再融资项目；红相股

份重大资产重组项目；水贝传媒新三板挂牌及定增项目。

李奕辰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：派能科技、振华新材等 IPO 项目；苏交科向特定对象发行、奥特迅非公开等再融资项目。

王秋韵先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：派能科技、威尔药业、东岳硅材等 IPO 项目；东方精工非公开、苏交科向特定对象发行等再融资项目；东方精工重大资产重组及浔兴股份控股权收购等并购重组项目。

刘建亮先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：锦泓集团、清源股份、威尔药业、东岳硅材、欣贺股份、派能科技等 IPO 项目；深圳机场、锦泓集团可转债，中葡股份、证通电子、锦泓集团非公开发行，翰宇药业、彩生活公司债等再融资项目；锦泓集团、浔兴股份重大资产重组等并购重组项目。

刘实先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：思维列控、大参林、深信服等 IPO 项目；大参林可转债，正海磁材、诺普信非公开发行，深信服向特定对象发行等再融资项目；正海磁材、盛路通信重大资产重组及配套融资等并购重组项目。

## 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

### （一）保荐机构内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会、深交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

**1、项目的立项审批**

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2021 年 1 月 22 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

**2、投行委质控部的审核**

本保荐机构在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

2021 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 25 日，投行委质控部对本项目进行了现场核查；2021 年 7 月 6 日，本项目的项目负责人向投行委质控部提出底稿验收申请；2021 年 7 月 19 日，投行委质控部对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

**3、内核部门的审核**

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2021 年 7 月 29 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2021 年 8 月 5 日召开内核会议对本项目进行了审议和表

决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、深交所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了上市保荐书。

**（二）保荐机构关于本项目的内核意见**

保荐机构内核委员会对本次发行进行审议后认为，本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规、深交所业务规则等规定的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会、深交所推荐。

## 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的

监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。

## 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

### （一）董事会的批准

2021 年 8 月 16 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

### （二）股东大会的批准

2021 年 9 月 2 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

经核查，本保荐机构认为发行人已就首次公开发行股票并在创业板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及深圳证券交易所的有关业务规则的决策程序。

## 八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《上市规则》上市条件的说明

### （一）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条规定的上市条件

发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件；发行人本次发行前股本总额为 38,317.50 万股，本次拟公开发行股份不低于 4,257.50 万股，发行后股本总额不低于 42,575.00 万股；发行人本次发行后股本总额超过 4 亿股，本次发行股份占发行后总股本的比例不低于 10%；发行人市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准。因此，发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条规定的上市条件。

**（二）发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条规定的上市条件**

依据《上市规则》第 2.1.2 条，发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。”

发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为 38,471.69 万元和 45,346.59 万元，符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的上市标准。

## 九、持续督导期间的工作安排

| 事项 | 工作安排 |
|---|---|
| （一）持续督导事项 | 在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | 强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | 协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | 督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。 |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。 |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 | 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。 |
| 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 | 严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。 |
| （二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 可列席发行人或相关当事人股东大会、董事会、监事会等有关会议；可要求发行人或相关当事人按照法律、行政法规、规章、深交所规则以及协议约定方式，及时通报信息；有充分理由确信发行人或相关当事人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人或相关当事人做出说明并 |

| 事项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| | 限期纠正，情节严重的，应当向中国证监会、深交所报告；按照中国证监会、深交所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。 |
| （三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 | 发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。 |
| （四）其他安排 | 无 |

## 十、保荐机构关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：杰理科技首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定；中信建投证券同意作为杰理科技本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名：

黄　勇

保荐代表人签名：

谭永丰　　陈　涛

内核负责人签名：

林　煊

保荐业务负责人签名：

刘乃生

保荐机构法定代表人签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

2021 年 9 月 6 日